



## 一种低密度、低成本、高强镍基单晶高温合金

文献类型：专利

作者 王栋；刘畅；张功；张健；楼琅洪

发表日期 2015-08-19

专利国别 中国

专利类型 发明

权利人 王栋；刘畅；张功；张健；楼琅洪

公开日期 2015-08-19

申请日期 2011-12-05

语种 中文

专利申请号 201110397153.0

源URL [<http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/76698>]

专题 金属研究所\_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 王栋,刘畅,张功,等. 一种低密度、低成本、高强镍基单晶高温合金. 2015-08-19.

**GB/T 7714**

入库方式：OAI收割

来源：[金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
27	0	0

## 其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

